

金属封装外壳生产厂家 安徽步微 深圳金属封装外壳

产品名称	金属封装外壳生产厂家 安徽步微 深圳金属封装外壳
公司名称	安徽步微电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县义井乡合淮路1幢119室
联系电话	18756088865 18756088865

产品详情

扁平式金属封装。该金属封装技术与前两类封装方式不同，首先其管座形式为蝶形，深圳金属封装外壳，因此在焊接时往往采用平行焊接的方式；为了加强管座与盖板的密封性，平行焊接的时间长于其他方式。如果采用激光焊接方式，则需要提高台阶盖板与蝶形管座的密封性，通过将蝶形管座的两侧打孔，金属封装外壳生产厂家，加固两者间的关系。

圆形金属封装。该金属封装技术在金属封装方式中应用较广，其利用圆形的特性使圆形管座与盖板无缝连接。因此，此种方式的密封性能最好，效果也最佳。

金属封装之Cu基符合材料有哪些特点呢？

Cu基复合材料

纯铜具有较低的退火点，它制成的底座出现软化可以导致芯片和 / 或基板开裂。为了提高铜的退火点，可以在铜中加入少量Al₂O₃、钨、银、硅。这些物质可以使无氧高导铜的退火点从320 升高到400 ，而热导率和电导率损失不大。国内外都有Al₂O₃弥散强化无氧高导铜产品，如美国SCM金属制品公司的Glid cop含有99.7%的铜和0.3%弥散分布的Al₂O₃。加入Al₂O₃后，热导率稍有减少，为365W(m-1K-1)，电阻率略有增加，为1.85 μ · cm，但屈服强度得到明显增加。

具体的封装形式

SOP/SOIC封装，金属封装外壳工艺，SOP是英文Small Outline Package 的缩写，即小外形封装。SOP封装技术由1968 ~ 1969年飞利浦公司开发成功，以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形

封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。

DIP封装，DIP是英文 Double In-line Package的缩写，金属封装外壳加工厂，即双列直插式封装。插装型封装之一，引脚从封装两侧引出，封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装，应用范围包括标准逻辑IC，存储器LSI，微机电路等。

金属封装外壳生产厂家-安徽步微-深圳金属封装外壳由安徽步微电子科技有限公司提供。安徽步微电子科技有限公司（www.buweidz.com）是安徽合肥五金模具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽步微领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽步微更加美好的未来。